

2026-2032年中国AI+网 络设备内生智能市场分析与行业调查报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2026-2032年中国AI+网络设备内生智能市场分析与行业调查报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/501285OR4H.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2026-09-25

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明: 《2026-2032年中国AI+网络设备内生智能市场分析与行业调查报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制,全面剖析了中国AI+网络设备内生智能市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议,规避市场风险,全面掌握行业动态。

第一章AI+网络设备内生智能行业概述1.1 内生智能网络设备的定义与技术内涵1.1.1 网络设备内生智能的概念界定1.1.2 内生智能 vs 外挂智能1.1.3 “网元—平台—应用”全栈AI新范式的内涵1.2 网络设备内生智能的核心技术特征1.2.1 自感知1.2.2 自决策1.2.3 自优化1.2.4 自执行/自愈1.3 网络设备内生智能的战略价值1.3.1 通信网络从“连接载体”向“智能中枢”跃迁的核心支撑1.3.2 自智网络(Autonomous Networks)高阶演进的必由之路1.3.3 AI算力网络(AI WAN/AI数据中心)的基础设施底座1.3.4 支撑“AI+信息通信”国家战略落地1.4 网络设备内生智能技术发展历程1.4.1 全球技术演进1.4.2 中国技术发展路径1.5 本报告数据来源及研究方法1.5.1 本报告数据来源1.5.2 本报告研究方法第二章中国AI+网络设备内生智能行业发展政策研究2.1 行业监管体系及机构职能2.1.1 监管体系2.1.2 核心监管机构2.2 网络设备内生智能行业标准建设2.2.1 国际标准参与2.2.2 国内标准研制现状2.2.3 网络智能体通信协议与互操作性标准瓶颈2.3 行业主要政策规划汇总及解读2.3.1 《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028年)》深度解读2.3.2 “人工智能+”国家战略相关部署2.3.3 新基建与智算网络建设相关政策2.3.4 网络自智能能力提升专项行动2.4 政策影响分析第三章网络设备内生智能产业成本拆解与降本路径3.1 成本结构拆解3.2 中长期降本路径3.3 隐形成本与技术对冲3.4 网络设备内生智能成本研究小结第四章中国AI+网络设备内生智能行业现状调查4.1 中国AI+网络设备内生智能行业发展历程4.1.1 技术探索期(2020年以前)4.1.2 概念验证期(2021-2023)4.1.3 技术突破期(2024-2025)4.1.4 政策引爆期(2026至今)4.2 行业运行现状4.2.1 产业发展阶段4.2.2 产业发展核心痛点4.2.3 投融资动态4.2.4 行业发展驱动因素4.3 市场现状4.3.1 全球AI网络设备市场现状4.3.2 中国AI网络设备市场现状4.3.3 自智网络市场现状4.4 中国AI+网络设备内生智能主要玩家及产品谱系调查4.4.1 设备商巨头4.4.2 数通专业厂商(4.4.3 运营商自研4.4.4 新兴力量4.5 行业竞争格局调查4.5.1 市场份额与订单获取情况4.5.2 技术梯队划分4.5.3 竞争力分析演变4.6 中国AI+网络设备内生智能产业链分析4.6.1 产业链全景图4.6.2 产业链成熟度4.6.3 价值链分布4.7 行业现状调查小结第五章网络设备内生智能产业链调查——上游(核心芯片与元器件)5.1 AI算力芯片5.1.1 端侧AI推理芯片(NPU/TPU)现状与主要玩家5.1.2 网络专用AI加速芯片(DPU/IPU)5.1.3 国产AI芯片在网络设备中的渗透现状5.2 高速光模块与光互联器件5.2.1 800G/1.6T高速光模块5.2.2 硅光技术(Silicon Photonics)与CPO(共封装光学)5.2.3 光芯片(

激光器芯片、探测器芯片)国产化进程5.3 高精度时钟与同步器件5.3.1 高精度时钟芯片5.3.2 网络同步与确定性时延保障器件5.4 上游关键挑战5.4.1 高端AI芯片“卡脖子”现状5.4.2 高速光芯片自主可控瓶颈5.4.3 先进制程工艺依赖5.5 上游产业链研究总结第六章网络设备内生智能产业链调查——中游(设备集成与制造)6.1 AI路由器6.1.1 AI路由器技术发展现状6.1.2 主要厂商产品型谱对比6.1.3 核心性能指标6.2 AI交换机6.2.1 AI数据中心交换机发展现状6.2.2 主要厂商产品型谱对比6.2.3 流量感知、丢包与时延可视化等内生智能能力6.3 AI基站与无线接入网设备6.3.1 5G-A/6G基站内生智能技术6.3.2 基带板卡内嵌AI SoC芯片方案6.3.3 无线空口智能化进展6.4 AI光传输设备(AI OTN)6.4.1 光传输设备内生智能技术发展6.4.2 网元内置算力与数字孪生技术融合6.5 批量化生产能力建设6.5.1 自动化装配与测试产线现状6.5.2 智能化网络设备制造能力6.6 中游产业链发展关键挑战6.6.1 电信级高性能与成本控制的平衡6.6.2 软硬件深度协同设计的复杂性6.6.3 标准化接口与快速交付能力6.7 中游产业链研究总结第七章网络设备内生智能产业链调查——下游应用场景(自智网络与运营商应用)7.1 运营商自智网络建设需求7.1.1 L4级高阶自智网络演进路径7.1.2 中国移动、中国电信、中国联通自智网络战略布局7.1.3 自智网络对网络设备内生智能的核心需求7.2 智能IP广域网(AI WAN)构建7.2.1 AI WAN架构7.2.2 内生安全可信与绿色低碳基础能力7.2.3 主要业务场景7.3 行业主要玩家7.4 2026-2032年自智网络与运营商应用领域市场空间测算7.4.1 全球自智网络市场预测7.4.2 中国市场测算7.5 自智网络与运营商应用发展趋势7.5.1 从L3向L4/L5高阶自智演进7.5.2 网络智能体(Network Agent)广泛应用7.5.3 大小模型协同与多智能体协同7.6 自智网络与运营商应用研究小结第八章网络设备内生智能产业链调查——下游应用场景(AI数据中心与智算网络)8.1 AI数据中心网络互联瓶颈8.1.1 大规模AI集群对网络带宽与时延的极致要求8.1.2 横向扩展(Scale-out)与纵向扩展(Scale-up)网络需求8.2 内生智能网络设备在智算中心的应用8.2.1 AI数据中心交换机内生智能能力8.2.2 网络丢包与时延的实时感知与自动优化8.2.3 网内计算(In-Network Computing)加速8.3 主要玩家与典型案例8.3.1 主要玩家8.3.2 典型案例8.4 市场空间与商业模式8.4.1 AI数据中心网络设备商业模式8.4.2 2026-2032年AI数据中心网络设备市场空间测算8.5 智算网络应用研究小结第九章网络设备内生智能产业链调查——下游应用场景(政企与行业专网)9.1 政企网络智能化升级需求9.2 工业互联网与智能制造场景9.2.1 工业网络对确定性时延与高可靠性的要求9.2.2 内生智能网络设备在工业场景的应用9.3 智慧园区与智能楼宇网络9.4 主要玩家9.5 政企与行业专网应用发展趋势9.6 政企与行业专网应用研究小结第十章中国AI+网络设备内生智能行业重点企业推荐10.1 中兴通讯股份有限公司10.1.1 企业概况10.1.2 企业优势分析10.1.3 产品/服务特色10.1.4 公司经营状况10.1.5 公司发展规划10.2 新华三集团10.2.1 企业概况10.2.2 企业优势分析10.2.3 产品/服务特色10.2.4 公司经营状况10.2.5 公司发展规划10.3 锐捷网络股份有限公司10.3.1 企业概况10.3.2 企业优势分析10.3.3 产品/服务特色10.3.4 公司经营状况10.3.5 公司发展

规划10.4 星网锐捷通信股份有限公司10.4.1 企业概况10.4.2 企业优势分析10.4.3 产品/服务特色10.4.4 公司经营状况10.4.5 公司发展规划10.5 富士康工业互联网股份有限公司10.5.1 企业概况10.5.2 企业优势分析10.5.3 产品/服务特色10.5.4 公司经营状况10.5.5 公司发展规划10.6 烽火通信科技股份有限公司10.6.1 企业概况10.6.2 企业优势分析10.6.3 产品/服务特色10.6.4 公司经营状况10.6.5 公司发展规划10.7 苏州旭创科技有限公司10.7.1 企业概况10.7.2 企业优势分析10.7.3 产品/服务特色10.7.4 公司经营状况10.7.5 公司发展规划10.8 基流科技10.8.1 企业概况10.8.2 企业优势分析10.8.3 产品/服务特色10.8.4 公司经营状况10.8.5 公司发展规划10.9 北京秩联科技有限公司10.9.1 企业概况10.9.2 企业优势分析10.9.3 产品/服务特色10.9.4 公司经营状况10.9.5 公司发展规划10.10 华为技术有限公司10.10.1 企业概况10.10.2 企业优势分析10.10.3 产品/服务特色10.10.4 公司经营状况10.10.5 公司发展规划第十一章网络设备内生智能行业趋势预测与市场空间测算11.1 行业发展趋势11.1.1 技术趋势11.1.2 产品趋势11.1.3 产业趋势11.1.4 竞争趋势11.2 行业发展主要风险11.2.1 技术迭代风险11.2.2 下游AI应用落地不及预期风险11.2.3 供应链安全与高端芯片禁运风险11.2.4 电信级可靠性验证周期长的风险11.2.5 安全与能效矛盾日益突出11.3 2026-2032年市场空间测算11.3.1 中国AI网络设备总体市场空间11.3.2 细分市场空间第十二章中国AI+网络设备内生智能产业研究总结与投资机会透视12.1 研究总结12.1.1 市场特点总结12.1.2 技术趋势总结12.1.3 企业格局总结12.2 2026-2032年投资机会多维透视12.2.1 市场痛点分析12.2.2 行业爆发点分析12.2.3 产业链投资机会12.2.4 新进入者投资机会12.3 产业投资策略与投资建议12.3.1 强化核心芯片与器件自主保障能力12.3.2 推动网络设备内生智能标准与接口统一12.3.3 鼓励“运营商+设备商+芯片商”协同创新模式12.3.4 提升我国网络设备内生智能标准的国际影响力12.4 产业发展壁垒12.4.1 技术壁垒12.4.2 资金壁垒12.4.3 人才壁垒12.4.4 准入壁垒12.4.5 生态壁垒

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/501285OR4H.html>